



TIA™800 系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上，这些胶带具有极强的粘合强度。

特性

- 》导热率 **0.8W/mK**
- 》高性能热传导压克力胶
- 》高粘结强度各种表面的双面压敏胶带

应用

- 》使散热片固定于已封装之芯片上
- 》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
- 》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式

TIA™ 800 系列特性表

产品型号	TIA802	TIA804	TIA806	TIA808	TIA810	TIA812	TIA815	测试方法
颜色	白色							目視
膠粘劑類型	压克力膠粘劑							*****
基材類型	N/A							*****
使用溫度範圍	-45 °C to 120 °C							*****
厚度	0.0019" 0.05mm	0.004" 0.101mm	0.006" 0.152mm	0.008" 0.203mm	0.010" 0.254mm	0.012" 0.304mm	0.015" 0.381mm	ASTM D374
擊穿電壓	> 600 Vac	> 1200 Vac	> 1800 Vac	> 2500 Vac	> 2700 Vac	> 3000 Vac	> 4000 Vac	ASTM D149
導熱率	0.8 W/mK							ASTM D5470
180° 剝離強度	> 1200 g/inch (Steel, Immediate)							PSTC-1
180° 剝離強度	> 1400 g/inch (Steel after 24 hrs)							PSTC-1
保持力 25 °C/Hours	> 48 Hours							PSTC-7
保持力 80 °C/Hours	> 48 Hours							PSTC-7

標準厚度:

0.0019" (0.05 mm) 0.004"(0.101mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm)
0.010"(0.254mm) 0.012"(0.304mm) 0.015"(0.381mm)

如需不同厚度請與本公司聯繫。

標準尺寸:

16" x 100'(406mm x 30.48M)TIA800系列可模切成不同形狀提供。

補強材料:

TIA™800系列卷材可帶玻璃纖維為補強。

如果您想了解更多导热材料的产品信息，请访问我司官网：<http://www.ziitek.com>



导热灌封胶 | 相变化材料 | 导热矽胶布 | 导热膏 | 导热双面胶 | 导热硅胶片 | 陶瓷散热片 | 石墨片 | 导热塑料

加拿大:

Tel: +001-604-2998559
E-mail: sales@thermazig.com

台灣:

Tel: +886-2-22771007
Fax: +886-2-22771075
E-mail: frances@ziitek.com.tw

东莞:

Tel: +86-769-38801208
Fax: +86-769-83791290
E-mail: angus@ziitek.com

昆山:

Tel: +86-512-57816297
Fax: +86-512-57816327
E-mail: kelvin@ziitek.com

成都:

Tel: +86-28-62379168
Fax: +86-28-62379168
E-mail: david_cd@ziitek.com

以上资料与说明相信是可靠的但不作为法律的解释或保证.用户须进行充分的测试与确认上述讯息适合用户所提出任何特殊的产品